



Brussel, 4 mei 2026
(OR. en)

12534/25
COR 5 (nl)

DUAL USE 40
CFSP/PESC 1293

BEGELEIDENDE NOTA

van: de Europese Commissie
ingekomen: 4 mei 2026
aan: het secretariaat-generaal van de Raad

nr. Comdoc.: C(2026) 3005 final

Betreft: **RECTIFICATIE van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2003 van de Commissie van 8 september 2025 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van producten voor tweërlei gebruik (*Publicatieblad van de Europese Unie L, 2025/2003, 14 november 2025*)**

De delegaties vinden hierbij document C(2026) 3005 final.

Bijlage: C(2026) 3005 final



Brussel, 29.4.2026
C(2026) 3005 final

RECTIFICATIE

**van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2003 van de Commissie van 8 september 2025
tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft de lijst van producten voor tweërlei gebruik**

(Publicatieblad van de Europese Unie L, 2025/2003, 14 november 2025)

RECTIFICATIE

van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2003 van de Commissie van 8 september 2025 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van producten voor tweeërlei gebruik

(Publicatieblad van de Europese Unie L, 2025/2003, 14 november 2025)

Bladzijde 6, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel I, tabel met acroniemen en afkortingen, rij betreffende EB-PVD, tweede kolom:

in plaats van: “Elektronenstraalverdampen”,

lezen: “Fysiske afzetting uit de dampfase met elektronenstraal”;

bladzijde 6, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel I, tabel met acroniemen en afkortingen, rij betreffende EDM, tweede kolom:

in plaats van: “Vonkerosie”,

lezen: “Vonkverspaningsmachines”;

bladzijde 82, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel IV, punt 2B001.d.:

in plaats van: “d. vonkverspaningmachines (EDM’s) van het draadloze type met twee of meer roterende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor “contourbesturen”;;”,

lezen: “d. vonkverspaningsmachines (EDM’s) van het draadloze type met twee of meer roterende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor “contourbesturen”;;”;

bladzijde 84, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel IV, punt 2B005.c., aanhef:

in plaats van: “productieapparatuur voor elektronenstraalopdampen (EB-PVD) welke een voedingssysteem gespecificeerd voor meer dan 80 kW omvat, met één van de volgende eigenschappen:”;

lezen: “productieapparatuur voor fysische afzetting uit de dampfase met elektronenstraal (EB-PVD) welke een voedingssysteem gespecificeerd voor meer dan 80 kW omvat, met één van de volgende eigenschappen:”;

bladzijde 105, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel IV, tabel “Afzettingstechnieken”, rij B.1., eerste kolom:

in plaats van: “B.1. Fysische afzetting uit de dampfase: Elektronenstraalverdampen (EB-PVD)”,

lezen: “B.1. Fysische afzetting uit de dampfase: fysische afzetting uit de dampfase met elektronenstraal (EB-PVD)”;

bladzijde 111, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel IV, technische noot betreffende tabel “Afzettingstechnieken”, punt b, vierde alinea, punt 1:

in plaats van: “1. bij elektronenstraalverdampen (EB-PVD) wordt gebruikgemaakt van een elektronenstraal voor het verhitten en verdampen van het materiaal waaruit de deklaag wordt gevormd;”;

lezen: “1. bij fysieke afzetting uit de dampfase met elektronenstraal (EB-PVD) wordt gebruikgemaakt van een elektronenstraal voor het verhitten en verdampen van het materiaal waaruit de deklaag wordt gevormd;”;

bladzijde 112, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel IV, technische noot betreffende tabel “Afzettingstechnieken”, punt g, tweede zin:

in plaats van: “De definitie omvat mede procedés waarbij tegelijk met de ionenimplantatie elektronenstraalverdamping of afzetting door middel van sputtering plaatsvindt.”;

lezen: “De definitie omvat mede procedés waarbij tegelijk met de ionenimplantatie fysieke afzetting uit de dampfase met elektronenstraal of afzetting door middel van sputtering plaatsvindt.”;

bladzijde 139, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B001.a., aanhef:

in plaats van: “apparatuur voor epitaxiaal opbrengen, als hieronder:”;

lezen: “apparatuur voor epitaxiale groei, als hieronder:”;

bladzijde 139, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B001.a.2.:

in plaats van: “2. reactoren voor het chemisch neerslaan van organometaaldamp (MOCVD), ontworpen voor het epitaxiaal opbrengen van samengestelde halfgeleiders van materiaal dat twee of meer van de volgende elementen bevat: aluminium, gallium, indium, arseen, fosfor, antimoon, zuurstof of stikstof;”;

lezen: “2. reactoren voor het chemisch neerslaan van organometaaldamp (MOCVD), ontworpen voor epitaxiale groei van samengestelde halfgeleiders van materiaal dat twee of meer van de volgende elementen bevat: aluminium, gallium, indium, arseen, fosfor, antimoon, zuurstof of stikstof;”;

bladzijde 139, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B001.a.3.:

in plaats van: “3. apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels met gebruik van gasvormige of vaste bronnen;”;

lezen: “3. apparatuur voor epitaxiale groei door middel van moleculaire bundels met gebruik van gasvormige of vaste bronnen;”;

bladzijde 139, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, NB bij punt 3B001.a.:

in plaats van: “NB: Zie 3B501.a.4. voor apparatuur ontworpen voor het epitaxiaal opbrengen van silicium (Si) of siliciumgermanium (SiGe).”;

lezen: “NB: Zie 3B501.a.4. voor apparatuur ontworpen voor epitaxiale groei van silicium (Si) of siliciumgermanium (SiGe).”;

bladzijde 141, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B501.a., aanhef:

in plaats van: “apparatuur voor epitaxiaal opbrengen, als hieronder:”;

lezen: “apparatuur voor epitaxiale groei, als hieronder:”;

bladzijde 141, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B501.a.4., aanhef:

in plaats van: “apparatuur ontworpen voor het epitaxiaal opbrengen van silicium (Si) of siliciumgermanium (SiGe), met alle volgende kenmerken:”;

lezen: “apparatuur ontworpen voor epitaxiale groei van silicium (Si) of siliciumgermanium (SiGe), met alle volgende kenmerken:”;

bladzijde 143, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, technische noot bij punt 3B501.n.1.b.:

in plaats van: “Voor de toepassing van 3B501.n.1.b. wordt onder ‘gebiedsselectieve afzetting’ verstaan de afzetting van materiaal op de zijwand, maar niet de bodem van een kenmerk.”;

lezen: “Voor de toepassing van 3B501.n.1.b. wordt onder ‘gebiedsselectieve afzetting’ verstaan de afzetting van materiaal op de zijwand, maar niet de bodem van een structuur.”;

bladzijde 143, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel V, punt 3B501.n.5.:

in plaats van: “5. apparatuur ontworpen voor afzetting met behulp van luchtbelvrij plasma van een laag met een diëlektrische constante lager dan 3,3, in ‘openingen’ met een ‘diepte-breedteverhouding’ gelijk aan of groter dan 1:1 en een breedte kleiner dan 25 nm;”;

lezen: “5. apparatuur ontworpen voor afzetting met behulp van holtevrij plasma van een laag met een diëlektrische constante lager dan 3,3, in ‘openingen’ met een ‘diepte-breedteverhouding’ gelijk aan of groter dan 1:1 en een breedte kleiner dan 25 nm;”;

bladzijde 248, in de bijlage tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821, deel XI, technische noten bij punt 9E003.c., punt 4:

in plaats van: “4. voor de vervaardiging van de gaten kunnen methoden als “laser” straalbewerking, waterstraalstraalbewerking, Electro-Chemical Machining (ECM) of Electrical Discharge Machining (EDM) worden gebruikt.”;

lezen: “4. voor de vervaardiging van de gaten kunnen methoden als “laser” straalbewerking, waterstraalstraalbewerking, Electro-Chemical Machining (ECM) of vonkverspanen (EDM) worden gebruikt.”.